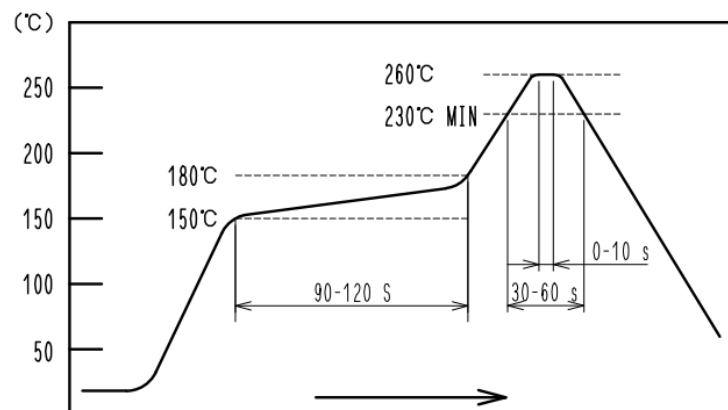


適用規格		IEC 61076-3-124					
定 格	使用温度範囲	-40℃ ～ +85℃ (RH95% MAX 注1, 2)		保存温度範囲	-30℃ ～ +60℃ (RH95% MAX 注1)		
	電圧	AC 50V / DC 60V		電流	1.5 A/pin (全端子)		
					3 A/pin (端子No. 1, 2, 6, 7のみ使用)		
性 能							
	項 目	試 験 方 法		規 格		QT	AT
構造	外観, 構造, 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。		図面と合致していること。		○	○
	表示	目視にて確認する。		図面と合致していること。		○	○
電 氣 的 性 能	接触抵抗	100 mA (DC OR 1000 Hz) 以下で測定する。		信号 : 30 mΩ 以下 (注3) シールド : 100 mΩ 以下 (注3)		○	—
	絶縁抵抗	DC 500 V で測定する。		500 MΩ 以上		○	—
	耐電圧	DC 500 V 1分間印加。(漏洩電流 2 mA 以下)		絶縁破壊がないこと。 		○	—
	挿入損失 (IL)	1～ 500 MHz にて測定する。		0.02√(f) dB 以下 (値が0.1dB以下の場合は0.1dBとする)		○	—
	反射損失 (RL)	1～ 500 MHz にて測定する。		68 - 20 log (f) dB 以上 (値が30 dB 以上の場合は30 dB とする)		○	—
	近端漏話 (NEXT)	1～ 500 MHzで測定する。		94 - 20 log (f) dB 以上 (1 MHz～250MHz) 46.04 - 30 log (f/250) dB 以上 (250 MHz～500MHz) (値が75 dB 以上の場合は75 dB とする)		○	—
	遠端漏話 (FEXT)	1～ 500 MHzで測定する。		83.1 - 20 log (f) dB 以上 (値が75 dB 以上の場合は75 dB とする)		○	—
	横方向変換損 (TCL)	1～ 500 MHzで測定する。		68 - 20 log (f) dB 以上 (値が50 dB 以上の場合は50 dB とする)		○	—
機 械 的 性 能	横方向伝達変換損 (TCTL)	1～ 500 MHzで測定する。		68 - 20 log (f) dB 以上 (値が50 dB 以上の場合は50 dB とする)		○	—
	総合挿抜力	挿抜速度 : 50 mm/min 以下 適合コネクタで測定する。		差込力 25 N 以下 引抜力 25 N 以下		○	—
	繰り返し動作	5000 回 の抜き差しを行う。 挿抜速度 : 10 mm/s 以下 挿抜間隔 : 5 秒 以上 (未かん合状態)		①接触抵抗 信号 : 80 mΩ 以下 (注3) シールド : 100 mΩ 以下 (注3) ②破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。		○	—
	耐振性	周波数 10 ～ 500 Hz, 片振幅 0.35 mm, 加速度 50 m/s ² , 3 軸向 各 2 時間試験する。		①1 μs 以上の電氣的瞬断がないこと。 (注4) ②破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。		○	—
注1. 結露のないこと。 注2. 使用温度範囲は通電による温度上昇も含む。							
注3. ケーブルの導体抵抗は含まない。							
注4. 電氣的性能については端子No3, 8を除く信号端子及びシールドに適用。							
	△の数	訂正記事		設計	検図	年月日	
	9	DIS-E-00014614		MT. YASUDA	KI. KAGOTANI	20231003	
備考				承認	RI. TAKAYASU	20170328	
				検 図	KI. NAGANUMA	20170327	
				担 当	TS. SAKAIZAWA	20170327	
				製 図	TS. SAKAIZAWA	20170327	
試験規格の記載のない試験方法は, IEC 60512(対応規格 JIS C 5402)を適用している。							
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目				図番	SLC-129430-00-00		
	製 品 規 格 表			製品名	IX61G-A-10P		
	ヒロセ電機株式会社			製品コード	CL0251-0021-0-00		1/4

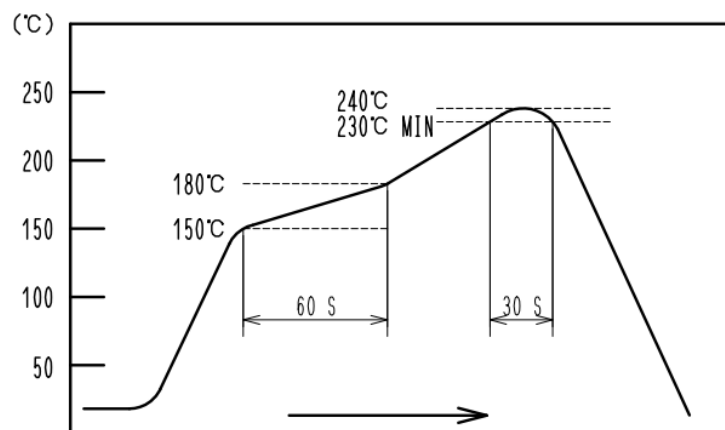
性能					
項目		試験方法	規格	QT	AT
機械的性能	耐微摺動摩耗性	加速度 490 m/s ² , 30 回/min の速度で 1000 回加える。	①1 μs 以上の電氣的瞬断がないこと。 (注4) ②破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐衝撃性	加速度 300 m/s ² , 持続時間 11 ms, 正弦半波 3 軸両方向 各 3 回衝撃を加える。 (計18回)	①1 μs 以上の電氣的瞬断がないこと。 (注4) ②接触抵抗 信号 : 80 mΩ 以下 (注4) シールド : 100 mΩ 以下 (注4) ③破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	—
	ロック強度	適合コネクタをかん合し、かん合軸方向に 80 N で60 秒 引張力を加える。	ロックのはずれ及び破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	—
	ロック操作性	20回/min 以下の速度で 10000回 ロック操作を行う。	①総合挿抜力 差込力 25 N 以下 引抜力 25 N 以下 ②破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	—
	基板固定強度	適合コネクタをかん合した後、上下左右方向に適合コネクタケース端に 30 Nの力を 1 回 1 秒間、各方向 25 回 加える。	基板剥離及び破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	—
環境的性能	温度サイクル	温度 -55 → 常温 → +85 → 常温 °C 時間 30 → 2~3 → 30 → 2~3 分 を 10 サイクル放置する。(かん合放置)	①耐電圧 : DC 500 V 1分間印加し(漏洩電流 2 mA 以下)、絶縁破壊がないこと。 ②接触抵抗 $\triangle$ 信号 : 80 mΩ 以下 (注3) シールド : 100 mΩ 以下 (注3) ③絶縁抵抗 : 500 MΩ 以上(乾燥時) ④破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	—
	温湿度サイクル	温度槽(低温時) : 25 °C 温度槽(高温時) : 65 °C 湿度 : 93 %RH 低温槽 : -10 °C 上記条件に 24 時間サイクル で 10 サイクル 放置する。 (IEC 60068-2-38, test Z / AD)	①耐電圧 : DC 500 V 1分間印加し(漏洩電流 2 mA 以下)、絶縁破壊がないこと。 ②接触抵抗 $\triangle$ 信号 : 80 mΩ 以下 (注3) シールド : 100 mΩ 以下 (注3) ③絶縁抵抗 : 500 MΩ 以上(乾燥時) ④総合挿抜力 差込力 25 N 以下 引抜力 25 N 以下 ⑤破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	—
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目			図番	SLC-129430-00-00	
HRS	製品規格表		製品名	IX61G-A-10P	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL0251-0021-0-00	$\triangle$ 2/4

性能					
項目		試験方法	規格	QT	AT
環境的 性能	定常状態の耐湿性	温度 +40 °C, 湿度 93 %RH 中に 21 日間放置する。(かん合放置)	①耐電圧：DC 500 V 1分間印加し(漏洩電 流 2 mA 以下)、絶縁破壊がないこと。 ②接触抵抗 $\triangle$ 信号：80 m Ω 以下 (注3) シールド：100 m Ω 以下 (注3) ③絶縁抵抗：500 M Ω 以上(乾燥時) ④総合挿抜力 差込力 25 N 以下 引抜力 25 N 以下 ⑤破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐熱性	温度 +85 $\pm$ 2 °C 中に 21日間放置する。 (かん合放置)	①耐電圧：DC 500 V 1分間印加し(漏洩電 流 2 mA 以下)、絶縁破壊がないこと。 ②接触抵抗 $\triangle$ 信号：80 m Ω 以下 (注3) シールド：100 m Ω 以下 (注3) ③絶縁抵抗：500 M Ω 以上(乾燥時) ④総合挿抜力 差込力 25 N 以下 引抜力 25 N 以下 ⑤破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐寒性	温度 -55 $\pm$ 3 °C 中に 10日間放置する。 (かん合放置)	①耐電圧：DC 500 V 1分間印加し(漏洩電 流 2 mA 以下)、絶縁破壊がないこと。 ②接触抵抗 $\triangle$ 信号：80 m Ω 以下 (注3) シールド：100 m Ω 以下 (注3) ③絶縁抵抗：500 M Ω 以上(乾燥時) ④総合挿抜力 差込力 25 N 以下 引抜力 25 N 以下 ⑤破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	塩水噴霧	濃度 5 % の塩水、試験温度 +35 $\pm$ 2 °C 中に 48 時間放置する。(未かん合放置)	端子接触部にはなはだしい腐食がないこ と。	○	—
	混合ガス試験	試験温度 +25 $\pm$ 1 °C、湿度 75 $\pm$ 3 %RH中 H ₂ S：10 $\pm$ 5 ppb, NO ₂ ：200 $\pm$ 50 ppb Cl ₂ ：10 $\pm$ 5 ppb, SO ₂ ：200 $\pm$ 20 ppb にかん合状態と未かん合状態で、それぞれ 4 日間放置する。 (IEC 60512, 方法4)	①接触抵抗 信号：80 m Ω 以下 (注3) シールド：100 m Ω 以下 (注3) ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	はんだ付け性	はんだ付け部をはんだ槽 245 $\pm$ 3 °C 中に 3 秒間浸漬させる。 (Rタイプフラックスを使用のこと)	はんだ浸漬面の 95 % 以上が新しい はんだでぬれていること。	○	—
	はんだ耐熱性 $\triangle$	図－1 のリフロー温度プロファイルにて 2 回 リフローする。	外観の変形及び端子などに著しいガタが ないこと。	○	—
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目			図番	SLC-129430-00-00	
HRS	製品規格表		製品名	IX61G-A-10P	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL0251-0021-0-00	$\triangle$ 3/4

性 能



△ 図-1 はんだ耐熱性プロファイル（コネクタ表面温度）



△ 図-2 推奨リフロー温度プロファイル（リード部温度）

注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目

図番

SLC-129430-00-00

HRS

製品規格表

製品名

IX61G-A-10P

ヒロセ電機株式会社

製品コード

CL0251-0021-0-00

△

4/4